

TÜV莱茵亮相SEMICON China 2023，助力半导体设备制造商拓展国内外市场

上海2023年7月13日 /美通社/ -- 日前，半导体和电子行业年度盛会SEMICON China 2023在上海新国际博览中心举行，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（以下简称“TÜV莱茵”）亮相本届展会，展示其在助力半导体设备制造商提高设备安全性方面的技术实力。



TÜV莱茵亮相SEMICON China 2023，助力半导体设备制造商拓展国内外市场

作为全球规模最大、最具影响力的半导体专业展之一，SEMICON China 2023的参展企业覆盖芯片设计、制造、封装、设备、材料、光伏、显示等半导体全产业链。SEMI（国际半导体设备材料产业协会）的报告数据显示，2022年全球半导体制造设备出货金额较2021的1,026亿美元增长5%，创下1,076亿美元的历史新高；其中，中国大陆连续第三年成为全球最大半导体设备市场。

半导体设备符合SEMI标准的安全评估已逐渐成为国内外买家对设备制造商的普遍要求。其中，SEMI S2、S6、S8、S26和F47标准涵盖大部分健康及安全规范，包括防范电气、机械、火灾、化学、辐射、噪音级人体工学等相关法规要求，也包括紧急停机系统、通风与废弃物排放规格以及危险警告等；SEMI S23则是半导体制造设备的能源、公用设施和材料使用效率指南。



TÜV莱茵为多家半导体设备制造商颁发产品认证证书

本次展会上，TÜV莱茵为多家半导体设备制造商颁发了产品认证证书，包括：为吉翔半导体设备（无锡）有限公司的尾气处理设备（Local Scrubber）颁发SEMI S2证书和TÜV莱茵China-mark（中国标识）认证证书；为江苏芯梦半导体设备有限公司的全自动晶舟清洗设备（Automatic FOUP Cleaner）颁发SEMI S2证书；为青岛国林半导体技术有限公司的臭氧发生装置颁发SEMI S2证书；为大连华邦化学有限公司的气体纯化设备颁发SEMI S2证书、CE-MD指令符合性证书以及China-mark认证证书。

作为全球领先的技术服务提供商，TÜV莱茵在半导体设备检测认证领域拥有10余年的丰富经验，是首批可针对半导体制造设备核发SEMI S2标识的第三方认证机构之一，其资深的专家团队可提供SEMI标准安规验证及CE符合性验证服务，还可依据国际国内标准提供定制化服务，助力半导体设备制造商高效拓展国内外市场。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/197843.html>